



Crème à braser LP 5707 SnPb(Ag)

INTERFLUX®
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique LP 5707 SnPb(Ag)

Ver. 3.01 30-06-14

Page 1

Crème à braser sans halogènes et sans nettoyage

Description

La crème à braser **LP 5707 SnPb(Ag)** est une crème sans nettoyage, sans halogènes et sans plomb qui a été développée pour le brasage sans azote et pour les hauts et longs profils de refusion .

De plus, la crème produit extrêmement peu de microbilles.

La chimie est absolument sans halogènes. La chimie utilisée dans la crème **LP 5707 SnPb(Ag)** prévient le démouillage quand elle est soumise aux températures élevées et aux longs profils de refusion, même dans les process de brasage sans azote.

La crème à braser garde ses propriétés rhéologiques sur le pochoir, également dans des conditions de haute et basse humidité.

De plus, la crème **LP 5707 SnPb(Ag)** a été formulée pour minimiser la formation de « voids ».

La crème à braser **LP 5707** est classée **RO LO** suivant les normes IPC et EN.



La photo n'est pas contractuelle

Plus d'informations

Profil de refusion	P. 2
Recommandations pour le profil	P. 2
Manipulation	P. 3
Résultats des tests	P. 3
Recommandations pour les paramètres	P. 4

Avantages:

- Résistante aux hauts et longs profils de refusion même sans azote
- Prévient le démouillage.
- Grande stabilité sur le pochoir, même sous des conditions atmosphériques extrêmes
- Réduit le microbillage
- Réduit le « voiding »
- Résidus faibles et transparents après refusion
- Absolument sans halogènes

Disponibilité

alliages	pourc. metal.	granulométrie	conditionnement
Sn63Pb37	sérigraphie: 89% - 90%	Standard classe 3 (25— 45µ)	Pot de 500g
Sn62Pb36Ag2	dispensing: 86%—87%	Les classes 4 et 5 sont disponibles pour certains alliages	Cartouches de 1kg—1,2kg—1,3kg
ATK anti tombstone			Seringues 5cc— 10cc— 30cc
			Autres conditionnements sur demande



Profil de refusion pour les alliages SnPb(Ag)

En général

La crème **LP 5707 SnPb(Ag)** est développée pour résister aux longs et hauts profils de refusion, également dans des conditions atmosphériques sans azote. Un profil de refusion de type linéaire ou avec un palier est possible.

En général, des profils avec un palier sont recommandés et peuvent être utilisés afin de limiter les différences de températures du circuit surtout sur des cartes possédant une grande diversité de composants, ou bien, pour diminuer ou éliminer la présence de

« voids ».
Quand vous brasez une carte avec un four à refusion, faites attention à ne pas surchauffer les composants, en particulier quand vous utilisez de la convection ou de l'infrarouge. Il est important de connaître les limites de tempé-

ratures de vos composants. Pour avoir une bonne appréciation de l'état thermique de votre carte, contrôlez votre profil de refusion avec des thermocouples. Mesurez sur des grands, des petits et des composants critiques en températures situés sur les côtés, au milieu et à proximité des gros

Recommandations pour le profil (alliages SnPb(Ag))

La crème à braser **LP 5707 SnPb(Ag)** possède une large fenêtre de process avec peu de limitations. Ci-dessous vous trouverez quelques exemples de profils de refusion qui peuvent être utilisés. Il est recommandé de limiter le pic de refusion à 250°C et la durée du

profil (de la température ambiante jusqu'au pic) au-dessous de 8 min.

Préchauffage

De la température ambiante jusqu'à +/- 120°C : max. 3°C/s. Des montées en températures plus élevées peuvent détruire des composants en raison

de l'humidité absorbée.

Palier

En général entre 120°C - 170°C: 0°C/s - 1°C/s.

Montée à refusion

Max. 4°C/s en raison de la différence du coefficient de dilatation thermique des composants.

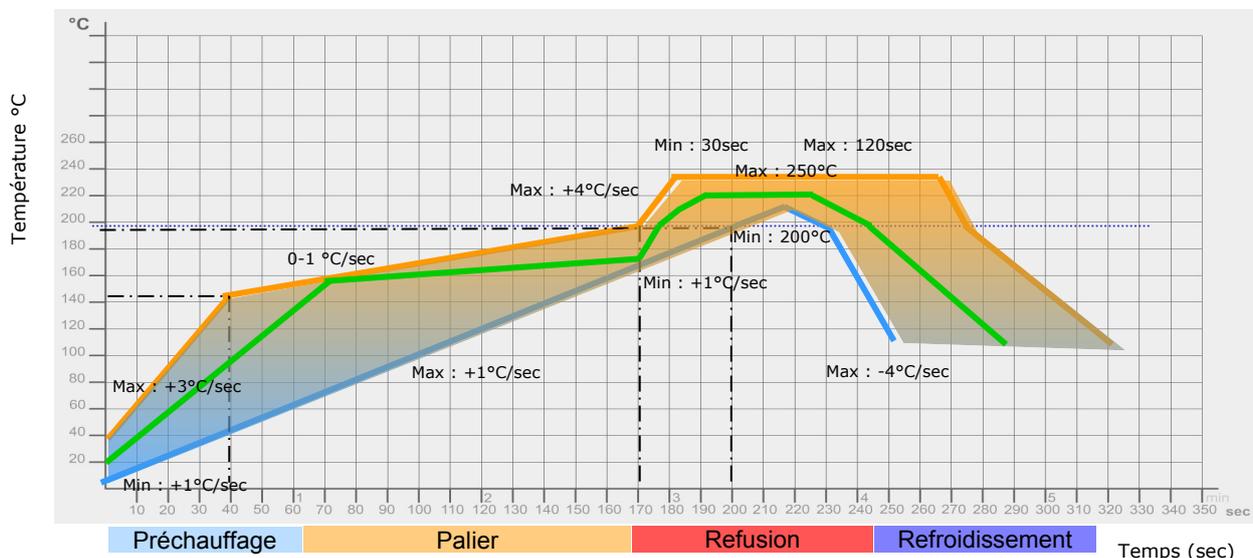
Refusion

Le pic de refusion est limité par les spécifica-

tions des composants et du circuit. En général entre 200°C et 230°C. Le temps au-dessus du liquidus est en général entre 45 et 90s.

Refroidissement

Pas plus vite que - 4°C/s en raison de la différence du coefficient de dilatation thermique des compo-





Manipulation

Stockage

Stocker la crème à braser dans les pots hermétiques d'origine à environ 3° à 7°C.

Manipulation

S'assurer que la crème soit à température ambiante dans le pot fermé pour éviter la condensation de l'eau. Mélanger avant toute utilisation.

Sérigraphie

Assurer une bonne

étanchéité entre la carte et le pochoir. N'appliquer pas plus de pression sur les racles que nécessaire, le pochoir doit être propre. Appliquer assez de crème à braser sur le pochoir afin que la crème puisse rouler aisément pendant la sérigraphie. Rajouter de la crème à intervalles réguliers.

Un nettoyage régulier du pochoir est recommandé. La fréquence

dépend du circuit, du pochoir et des conditions atmosphériques. Le produit de nettoyage **ISC8020** est recommandé en lingettes ou sous forme liquide.

Réutiliser la crème

Remettre le couvercle sur le pot et stocker le pot à l'abri de l'humidité, dans un conteneur fermé ou dans un sac prévu à cet effet. Avant tout réutilisation, tester la crème.

Pour un stockage de longue durée, remettre le couvercle intérieur ainsi qu' aucune bulle d'air soit enfermée, nettoyer les résidus de crème du pot et remettre le couvercle extérieur. Placer le pot dans le frigo. Avant tout réutilisation, s'assurer que la crème soit à température ambiante dans le pot fermé, mélanger et tester la crème.

Résultats des tests de fiabilité

Conforme à la norme IPC J-STD-004A/J-STD-005

Propriétés	Résultats	Méthodes
Chimique		
Miroir de cuivre	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Présence d'halogènes	aucune	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.28.1
Argent chromate (Cl, Br)	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
Classification du flux	RO LO	J-STD-004A
Environnement		J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Propriétés	Résultats	Méthodes
Mécanique		
Test de microbilles	après 15min	passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
	après 4h	passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
Test de mouillage		passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45
Test d'effondrement	après 15min à 25°C	passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	après 10min à 150°C	passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35



Recommandations et paramètres d'utilisation

Sérigraphie

Vitesse de sérigraphie: 20—150 mm/sec

Pression sur les racles: 250g—350g/cm

Température souhaitée: 15 à 25°C

Humidité souhaitée: 25 % à 90% h.r.

Assemblage CMS

durée du pouvoir collant ('tack time'): >8 heures

Test "in situ":

appropriée pour: "flying probe"
Planche à clous

Nom commercial du produit : LP 5707 SnPb(Ag) No-Clean, Halide Free Solder Paste

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

Le document dans une autre langue?:

www.interflux.com